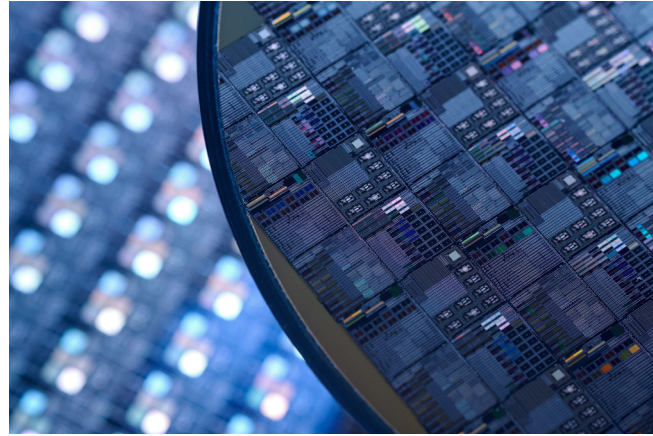


ALPHA[®] WS945CPS

适用于精细结构的高活性水溶性锡膏

ALPHA WS945CPS 是一款专为系统级封装 (SiP) 市场打造的新型 7 号粉锡膏。随着 SiP 市场的快速发展, 业界对互连性能以及更强的环境、健康与安全 (EHS) 的要求 日益提升。WS945CPS 正是为满足这些不断提升的需求而开发, 具备多项关键性能优势。

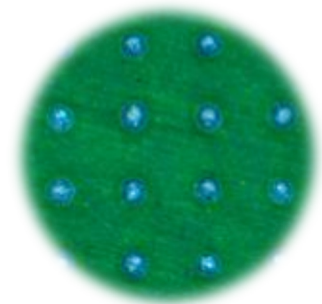


目标应用

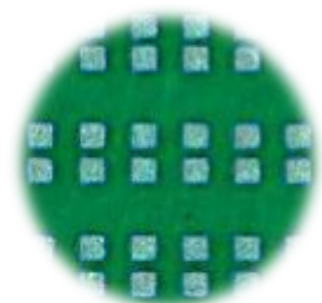
- 系统级封装 (SiP) 中的晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 及元件贴装
- 小开口及细间距半导体应用
- 晶圆、载板或面板上的微凸点 (MicroBump) 连接

主要产品特性

- 水溶性且无卤
- 提供 Type 6 与 Type 7 粉末规格
- 在小于 50 μ m 且纵横比 0.5 的开口中表现出出色的印刷性能
- 在 008004 芯片电容贴装中性能优异
- 适用于点胶、喷射与印刷工艺
- 在多种环境下具备优异的钢网寿命
- 良好的抗塌陷性、抗桥连性、粘性与低气孔率表现
- 可使用纯水 (DI 水) 轻松清洗
- 回流过程中珠状残留极少, 润湿性佳, 适应多种工艺条件



在 50 μ m 开口 (纵横比 0.50) 下展现优异的锡膏印刷性能



在 40 μ m 间距下无锡膏桥连现象

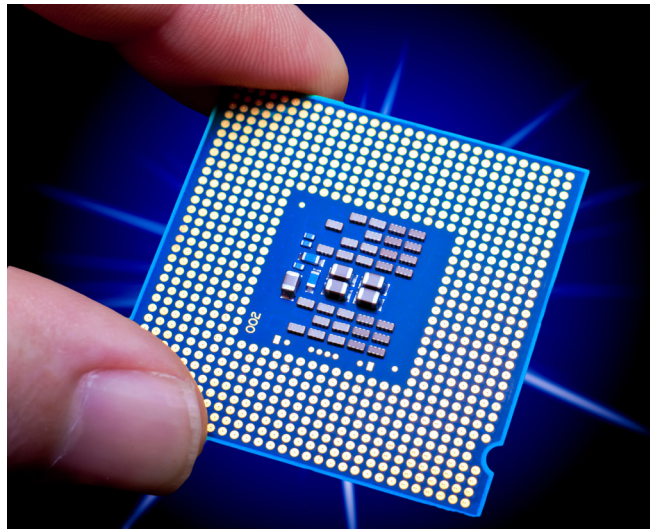
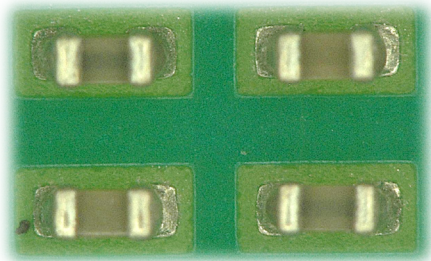
ALPHA[®] WS945CPS

适用于精细结构的高活性水溶性锡膏

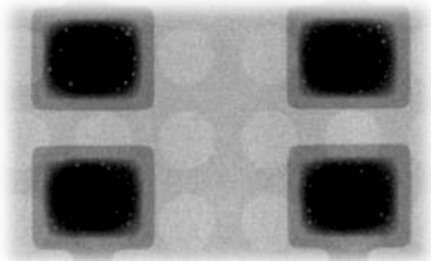
卓越性能

该产品通过在高密度、复杂元件布局中实现高精度锡膏转印,并具备优异的钢网寿命,从而显著提升了 SiP 制程的整体表现。

其出色的材料特性,如极低的塌陷率与优异的黏着性,有助于形成可靠的焊点,同时有效降低气孔、锡珠与桥连等缺陷,对于 SiP 应用中常见的紧凑复杂设计尤为关键。



在 008004 元件贴装中展现出良好的润湿性能



在 01005 元件贴装中具备良好的空洞控制表现

这款全新锡膏同时具备水溶性与无卤两大特性,有效降低生产过程中的环境、健康与安全 (EHS) 风险。

在系统级封装 (SiP) 生产中,它有助于减少有害气体排放与化学品暴露风险。水溶性锡膏简化了清洗与废弃物处理流程,而无卤配方则能最大限度地降低有毒副产物的产生,符合环保法规要求,同时提升工作场所的安全性。

